**□ 참가자 정보**

**2024 글로벌 소재·부품·장비 테크페어 기술이전 상담회 신청서**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **기업명** |  | | **대표자** |  |
| **사업자등록번호** |  | | **주소** |  |
| **업종** |  | | **주요생산품** |  |
| **매출액** |  | | **직원 수** |  |
| **담당자 연락처**  \*하단 개인정보  활용 동의 작성 | 성명 |  | **연락처** | 전화번호:  휴대폰번호:  이메일: |
| 부서/직위 |  |

**□ 상담회 신청 기술** *(첨부된 기술 리스트와 기술 소개서를 참고하여 최대 작성)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **기관명** | **기술분야** | **기술번호** | **기술명** |
| 1 | 한국화학연구원 | 반도체 | 화학-01 | 옵티컬 솔더링을 이용한 결합 구조에서 이차원 박막 반도체 물질의 광특성 생성 및 제어하는 방법 |
| 2 | 한국광기술원 | 광센서 | 광-02 | 광섬유를 이용한 화재 감지 및 고정형 멀티 센서  디바이스 |
| 3 |  |  |  |  |

**※ 상담신청 기술이 3건 이상일 시 행을 추가하여 작성해 주세요**

**□ 상담회 신청 기술 (신청 기술)을 선택한 사유 (※ 신청기술별 작성)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **기관명** |  | **기술분야** |  | **기술번호** |  |
| **기술명** |  | | | | |
| **신청사유** | *분량제한 없음* | | | | |
| **보유한**  **유관기술**  **소개** | *상담 신청한 기술과 관계된 기술을 보유 시 작성 / 분량제한 없음* | | | | |

|  |
| --- |
| <개인정보 활용 동의>  본인은「기술이전 상담회」참가와 관련하여 한국산업기술평가관리원과 전자신문사가 참가신청서에 기재된 개인정보를 수집·이용하고, 유관기관에 제공하는 것을 동의합니다.  1. 수집·이용의 목적 : 기업의 참가여부 조사 및 기술 상담, 사후 관리, 본회 사업홍보 및 안내  2. 수집하는 개인정보 항목 : 성명, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일 등  3. 보유 및 이용기간 : 참가신청서를 접수하는 시점부터 위의 이용목적이 종료되는 때까지  4. 참가자는 개인정보 제공 및 활용에 대해 동의하지 않을 권리가 있음  개인정보 활용에 동의함(체크) (성명: ) |

**\* 기타 회사/기술 소개자료 별도 첨부**

**\* 미팅 성사 여부 및 시간은 신청기술 담당 참여기관이 검토 후 최종 결정됩니다.**